



2010台北國際自動化科技大展

產學合作成果發表

專案/研究主題 矽晶圓電鍍(鑄)銅之研究

學校系所 東南科技大學 機電科技學系

計畫主持人 吳聲讓 技術教師

合作夥伴 奇翼創新科技股份有限公司

計畫重點 利用精準控制電鍍(鑄)銅成長速度，來達到預期的盲孔鍍(鑄)銅的高度，此基礎研究將有利於將來發展三維積體電路之盲孔或穿孔電鍍銅導線製程之發展。

效益/特色 此項基礎研究將有助於三維基體電路之發展，開發新技術，提高經濟效益。

教授專長 1.鑄造、2.精密鑄造、3.微電鑄

系統架構

